

2011年3月期業績予想修正及び 新しい配当政策について

代表取締役社長 竹中 博司

2010年11月2日



東京エレクトロン

事業環境



事業環境

▶ 半導体設備投資

旺盛な半導体需要を受けて、今期の前工程投資はほぼ倍増となる
来年前半には新規ラインが数多く計画されており、CY2011は10%程度の
成長を見込む

▶ FPD設備投資

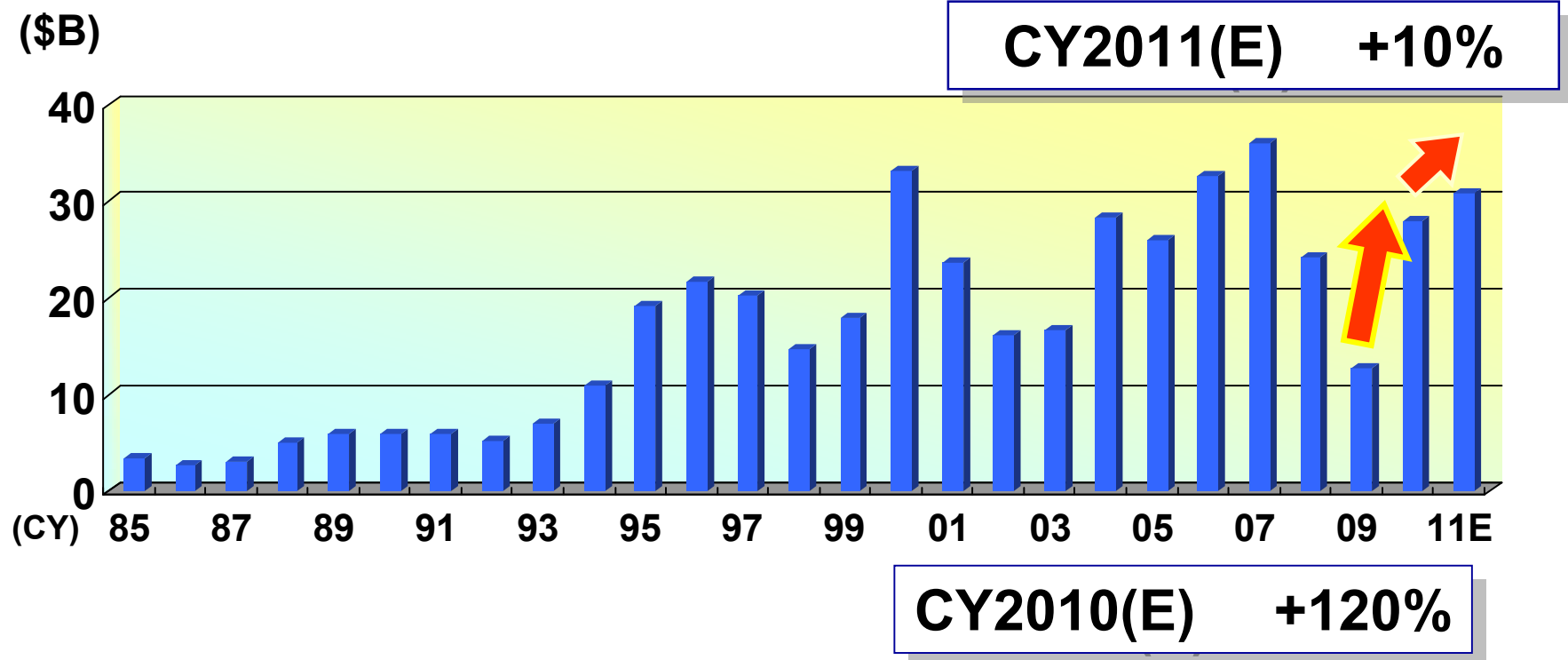
薄型TV需要による新規ライン建設投資は、中国を中心として継続
タブレットPC、スマートフォン市場の伸びによる中小型向けラインの新規
建設・追加投資も有り

▶ PV設備投資

価格優位性により、単結晶シリコン系や化合物(Cd-Te)系が好調
一方、薄膜シリコン系は変換効率の改善により、中・長期的には成長を期待



半導体前工程設備投資トレンド

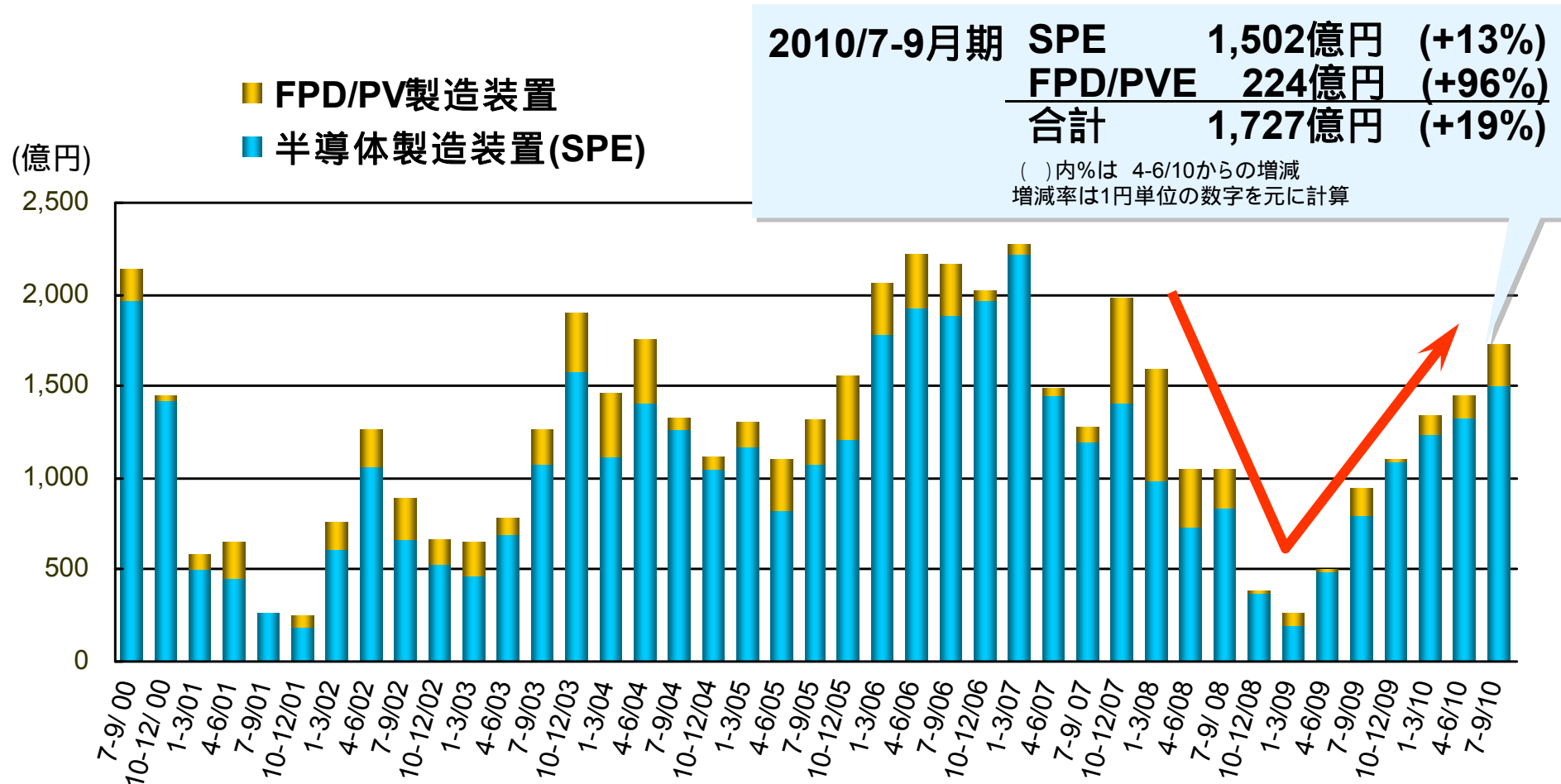


NAND及びロジックの新規ライン投資が2011年の装置市場を牽引

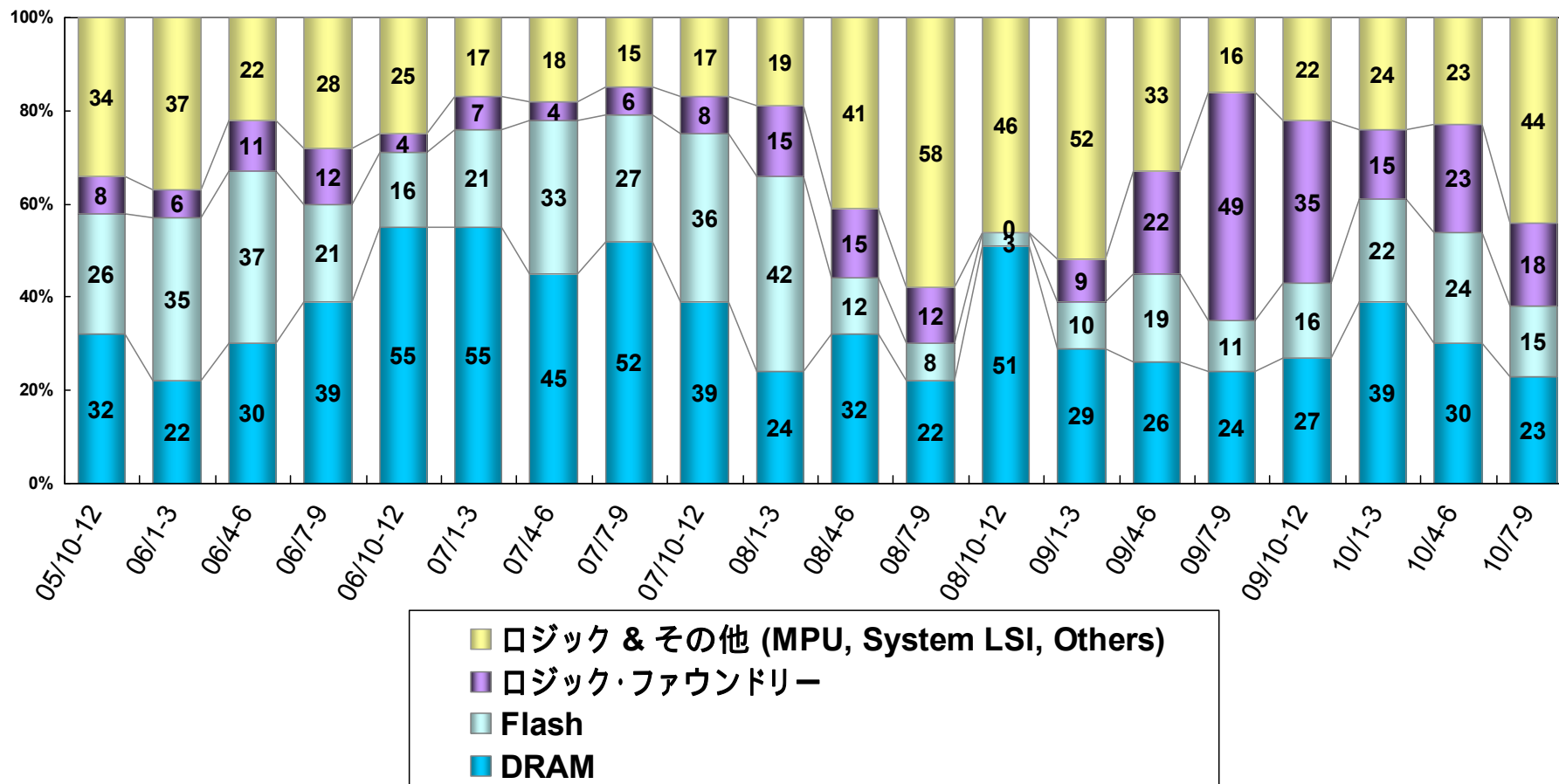
(Source: Gartner Dataquest, TEL Marketing) 28



四半期 SPE+FPD/PVE受注額



四半期 アプリケーション別SPE受注



注) グラフは装置本体受注における構成比を示しています

2011年3月期業績予想修正及び 新しい配当政策について



2011年3月期 業績予想修正

(億円)

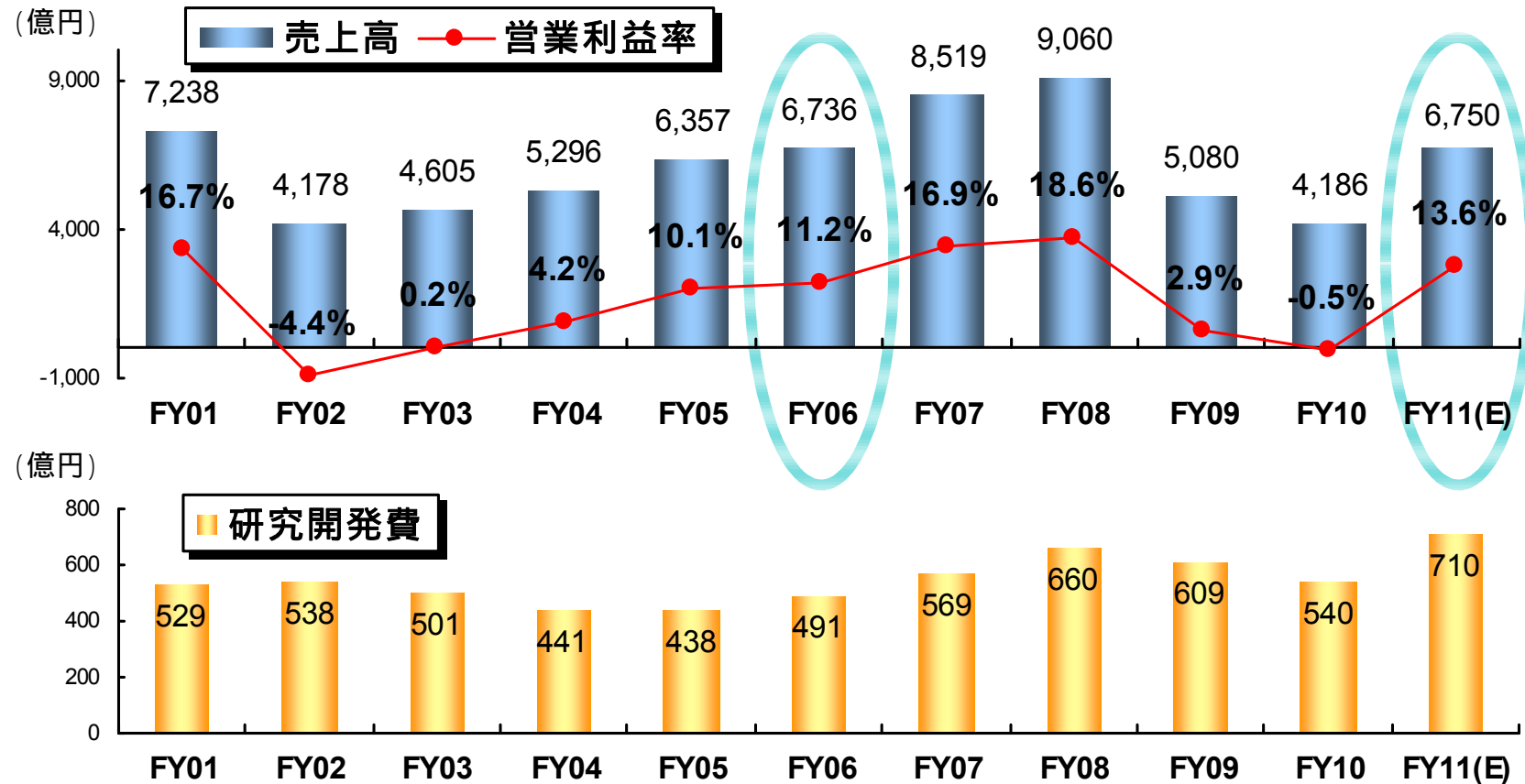
	2010年3月期	2011年3月期						通期 対前年 増減
		上期 (実績)	予想と の差額	下期 (最新予想)	修正額	通期 (最新予想)	修正額	
売上高	4,186	3,184	-66	3,566	+116	6,750	+50	+61%
SPE	2,623	2,402	-98	2,778	+168	5,180	+70	+97%
FPD/PVE	713	328	+8	317	-53	645	-45	-10%
EC/CN	844	450	+20	470	-	920	+20	+9%
その他	4	2	+2	3	+3	5	+5	+22%
営業利益	-21 (-0.5)	423 (13.3)	+18	497 (13.9)	+37	920 (13.6)	+55	+941
経常利益	25 (0.6)	451 (14.2)	+31	499 (14.0)	+39	950 (14.1)	+70	+925
税前利益	-77 (-1.9)	450 (14.1)	+30	480 (13.5)	+20	930 (13.8)	+50	+1,007
当期純利益	-90 (-2.2)	334 (10.5)	+34	326 (9.1)	-4	660 (9.8)	+30	+750

**SPEの収益性が想定以上に改善し、業績予想を上方修正
研究開発費を40億円積み増し、710億円に修正**

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ()内は利益率、単位は%
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



収益性の推移



研究開発費増額も、営業利益率は改善

事業別ハイライト

▶ 半導体製造装置

- エッチャー、洗浄装置の新POR獲得に注力
- 新エッチャー Tactras[®] RLSA[®] Etch、量産採用加速

▶ FPD製造装置

- 中国江蘇省昆山市に新製造拠点設立を決定

▶ 太陽電池製造装置

- Oerlikon Solar社、優れたコストパフォーマンス(€0.5/wp)の新製品“ThinFab”を発表

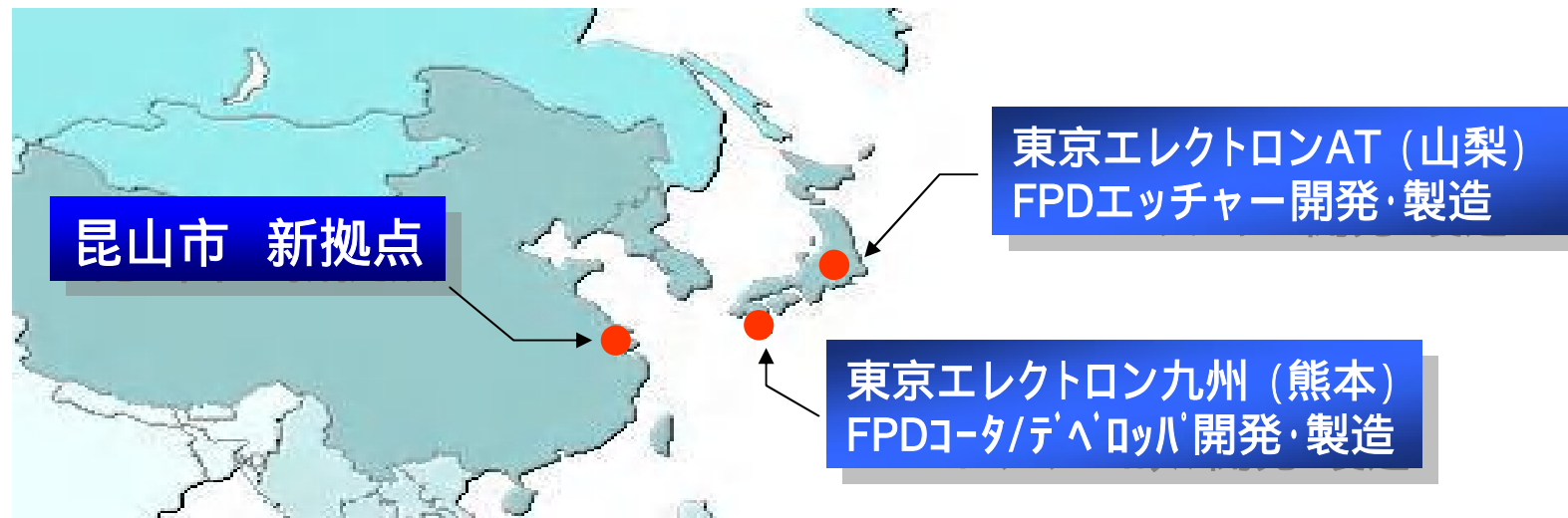
▶ 新規事業

- SiCエピタキシャル膜成長装置 Probus-SiC[™] 販売開始
- 3DI (3次元実装)装置のラインアップ拡充



FPD事業 中国における製造拠点の新設

当初は中国向けFPD製造装置の定期補修
将来的には改造および一部既存装置の生産拠点に



- 設立場所: 江蘇省昆山市 (上海近郊) 国家パネルディスプレイハイテク産業化基地
- 面積: 352千m²
- 投資総額: 約50億円
- 今後の予定: 2011年1月 新会社、東電光電半導体設備(昆山)有限公司を設立
2011年3月 建屋着工
2011年9月 建屋竣工



新しい配当政策について

事業や財務状況に関する中期的見通しをもとに、配当性向を引き上げ

新しい配当政策：

- 業績連動型・収益対応型配当の継続実施
- 連結当期純利益に対する配当性向35%目途
(従来は、配当性向20%目途)

将来の成長の礎となる研究開発・設備・人材への投資は引き続き積極的に実施する方針に変更はなし

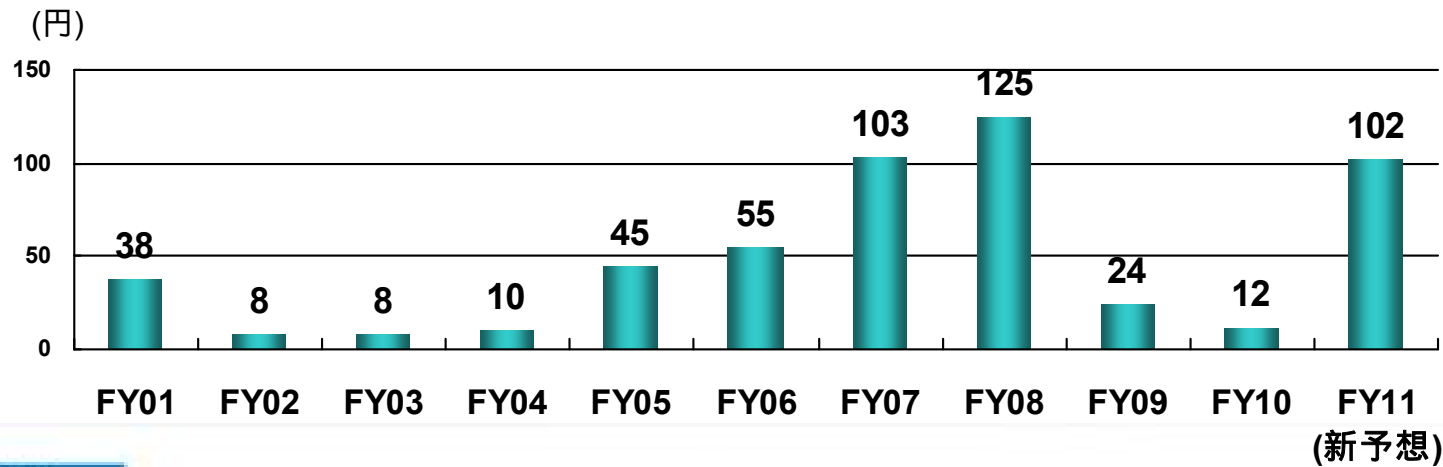
利益成長を通じた企業価値向上と、より積極的な株主還元



当期配当予想を上方修正

当期末配当より、連結配当性向20%目途から35%目途に変更

	1株当たり配当金		
	中間配当	期末配当	合計
11月2日公表	38円	64円	102円
7月30日公表	34円	37円	71円
(前期実績)	4円	8円	12円



■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

■ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

■ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池



